

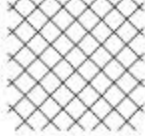


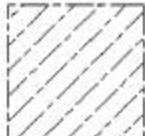






1. 结构工艺符号

操作		符号
	焊点分离（钻孔分开）	1 *
	贴合边准备和涂可焊导电涂层	2 
	点焊（包括点焊和MAG气体保护焊）	3 ·
	液态腊保护层	4 
	切割	5 
	冲孔	6 ○
	焊缝	7 
	涂密封胶	8 
	用刷子涂刷密封胶	9 
	涂防石击涂层	10 

操作		符号
划线	11	
涂导电密封胶	12	
烫锡	13	
喷涂发泡填充材料(指明喷射孔)	14	
喷涂空心体保护剂	15	
装密封薄膜	16	
涂直径为13mm 的密封胶	17	
涂直径为6mm 的密封胶	18	
涂带状密封胶2x20mm	19	
标记	20	
贴隔热隔音垫	21	